

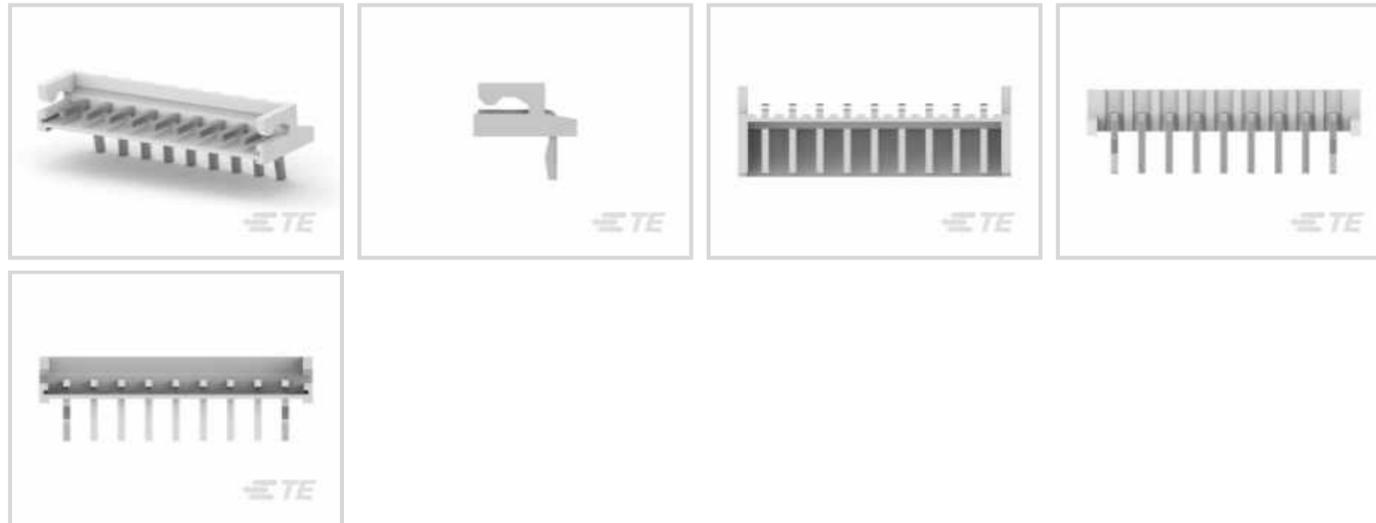
440053-9 ✓ AKTIV

Interne TE-Nummer 440053-9
PCB Mount Header, Right Angle, Wire-to-Board, 9 Position, 2.5 mm
[.098 in] Centerline, Partially Shrouded, Tin, Through Hole - Solder,
Signal, Natural

[Auf TE.com ansehen>](#)



Steckverbinder > PCB-Steckverbinder > Leiterplattenstiftleisten und -buchsen > AMP HPI 2.5 mm Headers



PCB-Steckverbindermontagetyp: **Stiftleiste für die Leiterplattenmontage**

Montageausrichtung für Leiterplatte: **Rechter Winkel**

Steckverbindersystem: **Draht-an-Leiterplatte**

Anzahl von Positionen: **9**

Raster: **2.5 mm [.098 in]**

[Alle AMP HPI 2.5 mm Headers \(78\)](#)

Eigenschaften

Produktmerkmale

PCB-Steckverbindermontagetyp	Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
Steckverbindersystem	Draht-an-Leiterplatte
Stecksockeltyp	Teilweise ummantelt
Abdichtbar	Nein
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

Montageausrichtung für Leiterplatte	Rechter Winkel
Anzahl von Positionen	9
Zeilenanzahl	1

Elektrische Kennwerte

Arbeitsspannung	250 VAC
-----------------	---------

Sonstige Eigenschaften

Primäre Produktfarbe	Naturbelassen
----------------------	---------------



Kontaktmerkmale

Länge des Steckbereichs des Kontakts	4 mm[.158 in]
Abmessungen des Steck-Quadratpfostens	.64 mm[.025 in]
Kontaktform	Quadratisch
Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Zinn
Kontaktmaterial	Messing
Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Zinn
Kontakttyp	Stift
Kontakt-nennstrom (max.)	3 A

Klemmenmerkmale

Quadratischer Endverschluss, Anschlussstift- und Restabmessungen	.64 mm[.025 in]
Anschlussstift- und Restlänge	3.4 mm[.134 in]
Verbindungsmethode für Leiterplatte	Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

Typ der Gegensteckführung	Polarisierung
Gegensteckführung	Mit
Art der Leiterplattenmontage	Geknickte Zacken
Montageausrichtung der Leiterplatte	Ohne
Gegensteckarretierung	Ohne
Arretierung für Leiterplattenmontage	Mit
Art der Steckverbindermontage	Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

Raster	2.5 mm[.098 in]
Gehäusematerial	Nylon 66 GF

Abmessungen

Steckverbinderlänge	25 mm[.984 in]
Steckverbinderhöhe	4.2 mm[.165 in]
Steckverbinderbreite	8.2 mm[.323 in]
Leiterplattendicke (empfohlen)	1 – 1.6 mm[.039 – .063 in]

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-25 – 85 °C[-13 – 185 °F]
---------------------------	---------------------------

Betrieb/Anwendung

Stromkreis Anwendung	Signal
----------------------	--------

Industriestandards

UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0
----------------------	----------

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	14000
Verpackungs-Typ	Tasche

Produkt-Compliance

[Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>](#)

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2021 (211) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogenen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
Lötfähigkeit	Nicht geeignet für bleifreie Verfahren

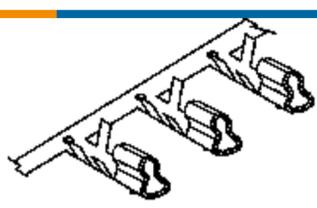
Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



TE Teilnr.: 440133-9
2.5MM,HSG,9POS



TE Teilnr.: 440134-1
2.5mm,Crimp Contact

Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilnr.:2299683-5
EP2.5 HDR 5P VERT W/O BOSS,
TAPING



TE Teilnr.:1-1744426-1
Header Housing Assy, EP 2.5 RA, 11
Pos.



TE Teilnr.:1376384-6
5mm POWER KEY 4P HDR ASSEMBL
HIGH TEMP



TE Teilnr.:2360545-5
SGI 1.5 HDR, 5P, RA, Key A, Natural



TE Teilnr.:2365497-2
EP2.5 single row SMT header,GWT



TE Teilnr.:3-2299683-5
EP2.5 HDR 5P VERT W/O BOSS,
TAPING,BLACK



TE Teilnr.:6-1376385-1
B-T-W CONN. 6P HDR ASSEMBL-
WITHOUT PIN2



TE Teilnr.:1-2368182-3
RA SMC2.5 Potting HDR_RED_3P



TE Teilnr.:2368182-7
RA SMC2.5 Potting header_7P



TE Teilnr.:2368182-9
RA SMC2.5 Potting header_9P

Dokumente

Produktzeichnungen

2.5MM,HDR,9POS,R/A

Englisch

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_440053-9_A2.2d_dxf.zip



Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_440053-9_A2.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_440053-9_A2.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/ Katalogseiten

[HPI Connectors QRG](#)

Englisch

Produktspezifikationen

[AMP 2.5MM PITCH HPI WIRE TO BOARD SYSTEM.](#)

Englisch

[Anwendungsspezifikation](#)

Englisch

Freigabe Agentur

[UL-Bericht](#)

Englisch